

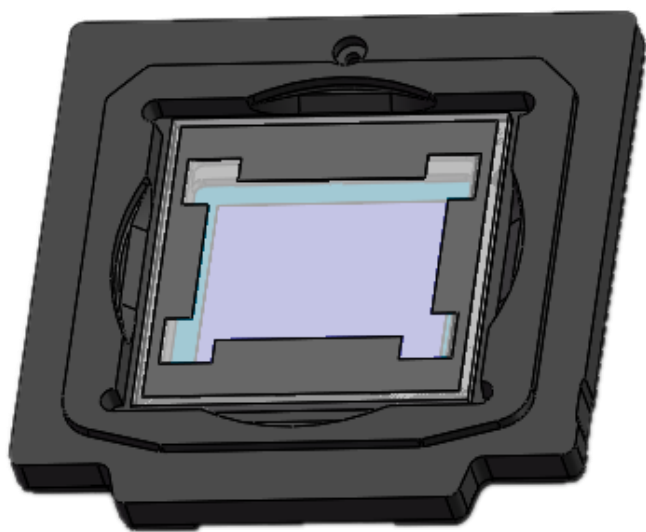
COM封装介绍

- Chip On Module -

(采用锡焊 COB 技术)

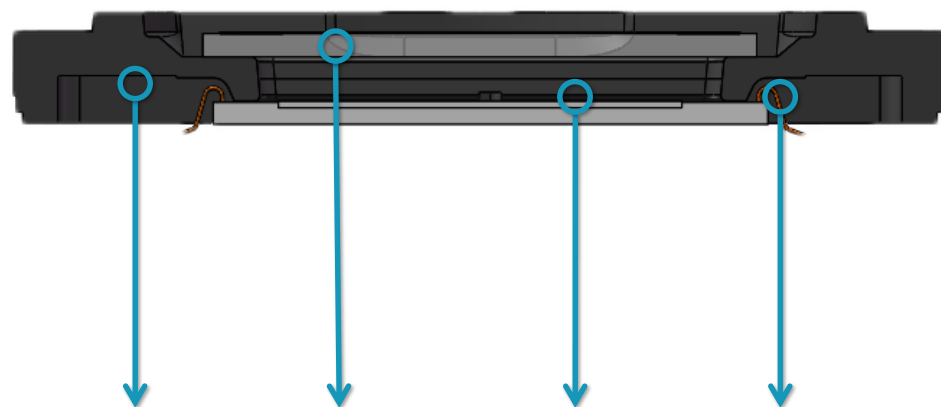
● ——— V4.3 ——— ●

COM 芯片



COM封装正面

COM封装剖面图

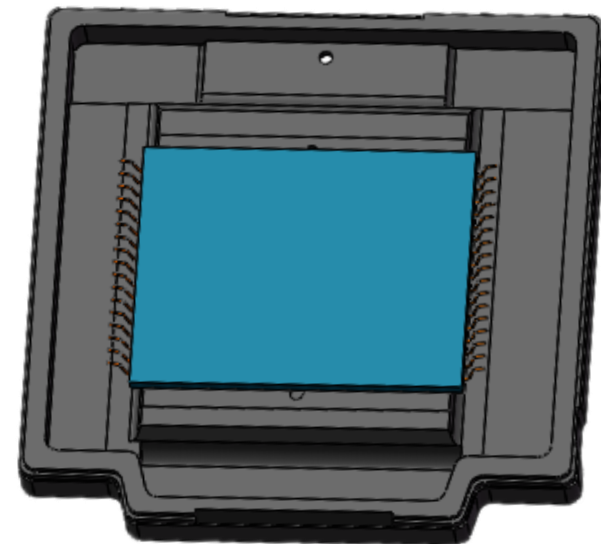


基座

IR 玻璃

CIS芯片

金线



COM封装背面



高性能的第三代CIS封装技术

1st Gen



2nd Gen



3rd Gen



CSP

Chip Scale Package

- 简单的制造工艺
- 光学性能较差
- 可靠性风险

COB

金线超声焊 COB

- 金线键合提高可靠性
- 去除CSP白玻璃提升光学性能
- 高成本和复杂的制造工艺
- Moving Particle问题

COM

锡焊 COB

- 更易管控的 Moving Particle
- 更少的光学系统误差
- 更高的键合可靠性
- 更优异的的散热性能
- 更具成本优势的生产制造
- IR需要丝印结构

COM 产品规划

系列	芯片型号	COM封装规格	状态
13M	GC13053	8.5*8.5	量产
8M	GC08A3	6.5*6.5 / 8.5*8.5	量产
5M	GC5035	6.5*6.5 / 8.5*8.5	量产
HD	GC1009	5.6*2.8	量产

- 产品路线图如有更改，恕不另行通知
- 详情请咨询格科微相关人员



THANKS

格物致知 盈科后进